

お客様各位

2020年11月吉日  
エスベック株式会社

## エスベック信頼性セミナー2020（ウェビナー）のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
コロナ禍において、安全に講演をお聞きいただける様に、エスベック信頼性セミナー2020をオンライン  
（ウェビナー形式）で開催する運びとなりました。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 敬具

記

### 開催要項

日 時：2020年12月2日（水） 13:30～16:00

場 所：オンラインでの開催（事前申込が必要です）

受講料：無料

申込方法：下記URLのWEBサイトよりお申込ください。

セミナー会場への入場には弊社から別途ご案内する入場キー(URL)が必要となりますので、必ず以下のお申込みフォームより申込みをお願いします。

締切日：2020年11月30日（月）

定員に達し次第申込みを終了いたします。

## ■ お申込みフォームはコチラ ↓ ↓ ■

<https://www.espec.co.jp/products/event/form.html>

\* 先着順での受付となりますのでお早めにお申し込みください。

\* 当社同業の企業様からの申込はご遠慮いただく場合がございます。予めご了承ください。

<問合せ先>

エスベック信頼性セミナー2020 事務局 <sup>くやま おがわ</sup>（久山・小川）

[Mail] [salesplanning\\_share@espec.co.jp](mailto:salesplanning_share@espec.co.jp)

[Tel] 06-6358-4751

以上

## 講演内容

\* 下記は講演順序ではございません。

\* 講演内容・発表者は変更する場合がございます。

### 〔特別講演〕

#### ▶「JTAG が変わる、IOT・5G 基板テスト」

発表：アンドールシステムサポート株式会社

エンベデッド開発事業部 プロダクトソリューションチーム 次長 谷口 正純 様



##### 「概要」

I o T、5 G に代表される電子機器は高密度化が進み、FPGA、CPU、メモリなどの電子部品は BGA パッケージが一般的に使われるようになりました。

近年、BGA 部品の小型化の影響で、BGA の実装不良が急増しており、製造検査では検出できず、不良品の市場流出が問題となっています。

いま、BGA 基板のテスト手法として注目を集めている「JTAG テスト（バウンダリスキャン）」の解説と BGA 基板の故障解析事例をご紹介します。

#### ▶「JTAG を活用した高密度実装基板の信頼性試験」

発表：エスペック株式会社 カスタム機器本部 今堀 翔也



##### 「概要」

I o T・5 G 向けの基板は、高集積及び小型化が進み、高密度実装された電子部品が実装されています。市場で発生した不具合を再現検証するにも製品基板の解析に時間を費やすこととなります。しかし検査工程で用いられる JTAG を環境試験装置と組み合わせることにより実基板（製品基板）による評価検証が可能となり、市場不良の再現が早期に可能となります。

今回、信頼性評価手法として JTAG テストを活用した HALT（高加速限界試験）による BGA パッケージの接合評価についてご紹介いたします。

### 〔特別講演〕

#### ▶「国内民間初のロケットと開発中の試行錯誤」

発表：インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役 稲川 貴大 様



##### 「概要」

グローバルな市場拡大を見込まれる宇宙ビジネスの中で、国内民間企業で初めて宇宙空間に到達した自社のロケット開発の変遷、ベンチャー企業ならではの取り組みや信頼性評価に関する事例を紹介します。

ロケットの打上げ時は機体が過酷な環境におかれることもあり、技術の発展には信頼性確保のため評価試験を行うことが非常に重要です。

講演ではその難しさや実際の具体例を挙げてご紹介いたします。